



Registerauszug zum Aktenzeichen 198 61 113.7

Stand am 18.05.2024
(letzte Aktualisierung in DPMAregister am 19.01.2016)

Es bestehen folgende Eintragungen:

Stammdaten

- [-----] **Schutzrechtsart:** Patent
- [-----] **Status:** Nicht anhängig/erloschen
- [21] **Aktenzeichen DE:** 198 61 113.7
- [54] **Bezeichnung/Titel:** Anordnung mit einer Substratplatte und einem Chip
- [51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 21/52 (2006.01)
- [51] **IPC-Nebenklasse(n):** B81C 3/00 (2006.01)
- [22] **Anmeldetag DE:** 30.06.1998
- [43] **Offenlegungstag:** 24.02.2000
- [-----] **Veröffentlichungstag der Erteilung:** 02.11.2000
- [71/
73] **Anmelder/Inhaber:** Micronas GmbH, 79108 Freiburg, DE
- [-----] **Erfinder:** Sieben, Ulrich, Dipl.-Phys. Dr., 79276 Reute, DE; Igel, Günter, Dipl.-Ing., 79331 Teningen, DE; Lehmann, Mirko, Dipl.-Phys., 79117 Freiburg, DE; Gahle, Hans-Jürgen, Dr., 79312 Emmendingen, DE; Wolf, Bernhard, Prof. Dr., 79252 Stegen, DE; Baumann, Werner, Dr., 79100 Freiburg, DE; Ehret, Ralf, Dr., 79291 Merdingen, DE;
- [10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE000019861113A1, DE000019861113C2
- [-----] **Zustellanschrift:** Micronas GmbH, 79108 Freiburg, DE
- [-----] **Zuständige Patentabteilung:** 33
- [62] **Teilung/Ausscheidung aus AKZ:** 198291213
- [57] **Zusammenfassung:** Eine Chip-Anordnung (1) hat eine Substratplatte (2), die einen Durchbruch (3) aufweist, in den ein Trägerchip (4) eingesetzt ist, der ein elektrisches oder elektronisches Bauelement (5) aufweist. In den Trägerchip (4) ist wenigstens eine Leiterbahn (7) integriert, die das Bauelement (5) mit

dem elektrischen Anschlußkontakt (8) verbindet. Der Trägerchip (4) ist derart in den Durchbruch (3) eingesetzt, daß er mit seinen Enden die einander abgewandten flachseitigen Oberflächen (9, 9') der Substratplatte (2) überragt und dadurch Überstände (10, 10') bildet. Dabei ist an dem die eine Oberfläche (9) überragenden Überstand (10) das Bauelement und an dem die andere Oberfläche (9') überragenden Überstand (10') der Anschlußkontakt (8) angeordnet und die das Bauelement (5) und den Anschlußkontakt (8) miteinander verbindende Leiterbahn (7) durchsetzt den Durchbruch (3). Zwischen der Substratplatte (2) und dem Trägerchip (4) ist eine Abdichtung angeordnet. Der Querschnitt des das elektrische oder elektronische Bauelement (5) aufweisenden Überstandes (10) verjüngt sich ausgehend von der Oberfläche (9) der Substratplatte (2) zu der am weitesten vorstehenden Stelle des Überstandes (10) (Fig. 1).

- [56] **Entgegenhaltungen/Zitate:** DE000002822391A1 (DE 28 22 391 A1); DE000002736200A1 (DE 27 36 200 A1); EP000000399227A1 (EP 03 99 227 A1)
- [43] **Erstveröffentlichungstag:** 24.02.2000
- [-----] **Anzahl der Bescheide:** 1
- [-----] **Anzahl der Erwiderungen:** 1
- [-----] **Erstmalige Übernahme in DPMAregister:** 26.05.2011
- [-----] **Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister:** 26.05.2011; 08.07.2011; 12.07.2011; 18.07.2011; 06.08.2011; 09.08.2011; 02.11.2011; 18.11.2011; 19.11.2011; 22.02.2012; 24.02.2012; 19.04.2012; 22.01.2013; 24.09.2013; 19.01.2016

Verfahrensdaten

Vorverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Die Anmeldung befindet sich in der Vorprüfung
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 24.07.1999

Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsantrag wirksam gestellt
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 24.07.1999
- [-----] **Antrag Dritter:** Nein
- [-----] **Eingangstag:** 24.07.1999

Vorverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Das Vorverfahren ist abgeschlossen
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 10.11.1999

Publikationen

- [-----] **Verfahrensart:** Publikationen
- [-----] **Verfahrensstand:** Offenlegungsschrift
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 24.02.2000

[-----] **Heftnummer:** 8
[-----] **Jahr:** 2000
[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 24.02.2000
[-----] **Publikationsart:** Schriften
[-----] **Teil:** Teil 1
[10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE000019861113A1

Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
[-----] **Verfahrensstand:** Erwidern auf Prüfungsbescheid
[-----] **Verfahrensstandstag:** 11.05.2000

Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
[-----] **Verfahrensstand:** Erteilungsbeschluss durch Prüfungsstelle/Patentabteilung
[-----] **Verfahrensstandstag:** 15.06.2000

Anmelder-/Inhaberänderung

[-----] **Verfahrensart:** Anmelder-/Inhaberänderung
[-----] **Verfahrensstand:** Änderung des Anmelders/Inhabers
[-----] **Verfahrensstandstag:** 11.10.2000
[-----] **Heftnummer:** 50
[-----] **Jahr:** 2000
[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 14.12.2000
[-----] **Publikationsart:** Bibliografiedaten
[-----] **Teil:** Teil 3
[71/
73] **Anmelder/Inhaber:** Micronas GmbH, 79108 Freiburg, DE
[71/
73] **Früherer Anmelder/Inhaber:** Micronas Intermetall GmbH, 79108 Freiburg, DE

Publikationen

[-----] **Verfahrensart:** Publikationen
[-----] **Verfahrensstand:** Patentschrift
[-----] **Verfahrensstandstag:** 02.11.2000
[-----] **Heftnummer:** 44
[-----] **Jahr:** 2000
[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 02.11.2000
[-----] **Publikationsart:** Schriften
[-----] **Teil:** Teil 3
[10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE000019861113C2

Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Patent rechtskräftig erteilt
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 02.02.2001
- [-----] **Heftnummer:** 18
- [-----] **Jahr:** 2001
- [-----] **Veröffentlichungsdatum:** 03.05.2001
- [-----] **Publikationsart:** Bibliografiedaten
- [-----] **Teil:** Teil 3

Klassifikationsänderung

- [-----] **Verfahrensart:** Klassifikationsänderung
- [-----] **Verfahrensstand:** Änderung der IPC-Hauptklasse
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 17.10.2005
- [51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 21/52 (2006.01)
- [51] **Frühere IPC-Hauptklasse:** H01L 21/52 (2000.01)

Vertreteränderung

- [-----] **Verfahrensart:** Vertreteränderung
- [-----] **Verfahrensstand:** Änderung des Vertreters
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 08.08.2011
- [74] **Früherer Vertreter:** Huwer, Andreas, Dipl.-Ing. Dr.-Ing., 79100 Freiburg, DE

Verwaltungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Verwaltungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Die Anmeldung gilt als zurückgenommen wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr/das Schutzrecht ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 03.01.2012
- [-----] **Heftnummer:** 16
- [-----] **Jahr:** 2012
- [-----] **Veröffentlichungsdatum:** 19.04.2012
- [-----] **Publikationsart:** Bibliografiedaten
- [-----] **Teil:** Teil 3